

中信建投证券股份有限公司

关于深圳精智达技术股份有限公司使用部分募集资金 向控股子公司提供借款实施募投项目的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐机构”）作为深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“精智达”“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件，对精智达使用部分募集资金向控股子公司合肥精智达集成电路技术有限公司（以下简称“精智达集成电路”）提供借款实施募投项目相关事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年5月26日出具的《关于同意深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1170号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,350.2939万股，每股发行价格为人民币46.77元，募集资金总额为人民币109,923.25万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币11,266.79万元后，募集资金净额为人民币98,656.46万元。上述募集资金已于2023年7月13日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2023]000414号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据《深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投入金额	实施主体
1	新一代显示器件检测设备研发项目	19,804.75	19,800.00	精智达

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投入金额	实施主体
2	新一代半导体存储器件测试设备研发项目	16,205.67	16,200.00	精智达集成电路
3	补充流动资金	24,000.00	24,000.00	精智达
合计		60,010.42	60,000.00	-

三、本次使用部分募集资金向控股子公司提供借款情况

为保障“新一代半导体存储器件测试设备研发项目”项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向精智达集成电路提供借款用于实施该项目，借款额度不超过人民币 16,200.00 万元，借款期限自借款发放之日起 3 年，借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）计算。公司将根据募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的建设安排及资金需求，一次或分次向精智达集成电路提供借款，借款的进度将根据募投项目的实际需求推进。精智达集成电路可根据其实际经营情况分期、提前或到期一次性偿还公司借款和利息。

本次借款精智达集成电路其他股东将不对上述项目同比例提供借款，借款仅限于“新一代半导体存储器件测试设备研发项目”的实施，不得用作其他用途。

四、借款对象基本情况

公司名称	合肥精智达集成电路技术有限公司			
成立日期	2021 年 1 月 7 日			
注册资本	6,250.00 万元			
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区兴业大道与光福路西北角空港集成电路标准厂房 B 栋 3 层			
经营范围	集成电路及半导体专用设备的研发、生产、组装、销售；半导体设备配套部件、辅件、治具的研发、生产和销售；提供技术咨询、技术服务；精密仪器、设备维修及维护；国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
股东构成	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）	
	深圳精智达技术股份有限公司	5,000.00	80.00	
	合肥市丰利莱企业管理合伙企业（有限合伙）	1,250.00	20.00	
主要财务数据（单位：万元）				
截止日/期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2022-12-31/ 2022 年度	11,271.09	4,396.60	5,098.70	246.09

注：以上财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

五、本次提供借款的目的及对公司的影响

公司本次向控股子公司精智达集成电路提供借款是基于推进募集资金投资项目建设的需要，符合募集资金使用计划，募投项目的实施主体及实施方式与《深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露一致，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次借款后，精智达集成电路的资金实力将进一步提高，有利于其经营发展和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

六、本次提供借款后的募集资金管理

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，本次借款将存放于募集资金专户进行管理，经董事会审议，精智达集成电路将开立募集资金专户，并与公司、募集资金专户监管银行、保荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议，严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求规范使用募集资金。

七、相关审议情况及专项意见

（一）董事会、监事会审议情况

公司于2023年9月27日分别召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》。同意公司以部分募集资金向精智达集成电路提供总额不超过人民币16,200.00万元的借款以实施募投项目，将募集资金从公司募集资金专户划转至前述公司募集资金专用账户。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用部分募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目，是基于推进募集资金投资项目建设的需要，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。该议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意使用部分募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目。

（三）监事会意见

监事会认为：公司使用募集资金对控股子公司提供借款用于实施募集资金投资项目，是基于推进募集资金投资项目建设需要，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。因此，监事会同意公司使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次向控股子公司精智达集成电路提供借款是基于推进募集资金投资项目建设需要，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害上市公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳精智达技术股份有限公司使用部分募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：


谢思遥


赵润璋

中信建投证券股份有限公司

2023年04月28日